

2. Gör universitetens pilotlinjer produktionsdugliga i liten skala – enligt samma modell som IHP

Qamcom instämmer i inriktningen i artiklarna 4.4 b, 5 b och 6 om pilotlinjer, testbeds och kompetenscentrum, men anser att genomförandet i Sverige behöver bli mer konkret. I praktiken stannar mycket av den svenska infrastrukturen, till exempel Myfab vid Chalmers, KTH, Lunds universitet och Uppsala universitet, vid forskning och prototyper. Tyska IHP (Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik) visar att en forskningsanknuten linje även kan leverera kommersiellt gångbara småserier till externa kunder. För mindre teknikbolag som behöver några tiotal eller hundratals kretsar, inte miljonvolym, är avsaknaden av en motsvarande väg från prototyp till småskalig kommersiell produktion i Sverige ett direkt hinder.

Vi föreslår att Sverige verkar för att medel inom Chips Act 2.0 uttryckligen får användas för att uppgradera universitetens pilotlinjer, till exempel inom Myfab, så att de klarar kommersiellt godtagbar kvalitet och spårbarhet vid liten volym enligt samma modell som IHP, och inte enbart forskningsprototyper.

3. Satsa på öppen programvara för kretsdesign för att sänka trösklarna för nischade ASIC-lösningar

Qamcom föreslår att artiklarna 6 och 7 kompletteras på denna punkt. Vi ser en växande marknad för nischade och specialanpassade kretslösningar som stora etablerade designhus av kommersiella skäl väljer att inte prioritera, men som mindre svenska teknikbolag är väl positionerade att möta – förutsatt att verktyg och tillgång till pilotproduktion görs tillgängliga. Öppen programvara och öppna verktygskedjor för kretsdesign sänker tröskeln för SME och start-ups att gå från idé till färdig krets, kortar tiden till marknad och minskar beroendet av dyra kommersiella licenser som annars gynnar redan etablerade aktörer.

Vi föreslår att Sverige verkar för att kompetenscentrumen enligt artikel 6 och prioriteringen inom de nyinrättade Grand Challenges enligt artikel 7 – storskaliga, sektorsövergripande satsningar på strategiska teknikutmaningar, till exempel nästa generations AI-chip, vars närmare utformning och finansiering ännu inte är fastlagd i förhandlingarna – uttryckligen omfattar utveckling och underhåll av öppen programvara och öppna designverktyg för kretsutveckling, som en del av EU:s strategi för att bredda deltagandet i halvledarekosystemet.



Sofia Persson Björk / Sales Developer



Olof Kindgren / Sr ASIC Designer



Johan Lassing / CEO

Qamcom AB

stockholm@qamcom.com, +46704268166